

御中

プロダクト／プロセス変更通知書
Product/Process Change Notification (PCN)

件名: MPC8347/8349 TBGAパッケージのモールドプロセス変更

《お願い》

本変更通知に関してご意見・ご要求のある場合は、作成日より一ヵ月以内に弊社担当営業までご連絡くださいますようお願い申し上げます。

尚、ご連絡が無い場合は本変更が承認されたと判断させていただきます。



2011年10月4日

フリースケール・セミコンダクタ・ジャパン株式会社

プロダクトマーケティング本部

該当GPCN番号:

14740

変更内容:

事前にお知らせいたしましたTBGAパッケージのモールド部封止方法を弊社独自のプロセスからセンターモールドゲートと呼ばれる封止方法に変更することについて、MPC8347/8349製品について改めて正式にご連絡いたします。

変更理由:

幅広く使用されているプロセス・部材に変更することで、長期供給サポートの観点で部材調達リスクを軽減するため。

対象製品:

添付別紙をご参照ください。

変更（変更品出荷）時期:

変更開始日：2011年12月14日

出荷日を特定することはできません。

変更品の見分け方:

なし

その他:

関連通知【JPCN2011-0120 (P14740)】 [事前通知]MPC8347/9, MPC8358/60及びMPC8270/80 TBGAパッケージのモールドプロセス変更

【JPCN2011-0129(14740)対象製品】

MPC8347CVVAGDB
MPC8347CVVAJDB
MPC8347CVVAJFB
MPC8347CZUAGDB
MPC8347CZUAJDB
MPC8347ECVVAGDB
MPC8347ECVVAJDB
MPC8347ECZUAGDB
MPC8347ECZUAJDB
MPC8347EVVAGDB
MPC8347EVVAJDB
MPC8347EVVAJFB
MPC8347EVVALFB
MPC8347EZUAJDB
MPC8347EZUAJFB
MPC8347EZUALFB
MPC8347VVAGDB
MPC8347VVAJDB
MPC8347VVAJFB
MPC8347VVALFB
MPC8347ZUAGDB
MPC8347ZUAJDB
MPC8347ZUAJFB
MPC8347ZUALFB
MPC8349CVVAGDB
MPC8349CVVAJDB
MPC8349CZUAGDB
MPC8349CZUAJDB
MPC8349ECVVAGDB
MPC8349ECVVAJDB
MPC8349ECVVAJFB
MPC8349ECZUAJDB
MPC8349EVVAGDB
MPC8349EVVAJDB
MPC8349EVVAJFB
MPC8349EVVALFB
MPC8349EZUAGDB
MPC8349EZUAJDB
MPC8349EZUAJFB
MPC8349EZUALFB
MPC8349VVAGDB
MPC8349VVAJDB
MPC8349VVAJFB
MPC8349VVALFB

【JPCN2011-0129(14740)対象製品】

MPC8349ZUAJDB
MPC8349ZUAJFB
SC41019B
SC41023B
SC41050B
SC41114B
SC411201B
SC8347VVAJFB